

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-014

有研半导体硅材料股份公司 关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于与各银行签订 2023 年度综合授信的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 6.10 亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下：

为保障公司 2023 年度经营发展的需要，2023 年度，公司及子公司拟向相关金融机构以信用方式申请合计不超过人民币 6.10 亿元的综合授信额度。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度明细如下：

序号	公司名称	授信银行	拟授信额度 (万元)
1	有研半导体硅材料股份公司	中国民生银行股份有限公司 北京分行	5,000.00
2	有研半导体硅材料股份公司	招商银行股份有限公司 北京分行	6,000.00

3	山东有研半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	20,000.00
4	山东有研半导体材料有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	30,000.00
合计			61,000.00

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限为 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

在综合授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 3 月 30 日